盒式金属化聚酯膜电容器

(MEB/CL21B)规格书

特点

■电容器容量范围从 0.01uF 到 2.2uF。

■工作温度：-40℃～125℃ 。

(+105℃ 到 +125℃ 每上升 1℃，降低 1.25%倍电压)

■储存温度：15℃~35℃。

■有自愈的性能。

■高阻抗。

■良好的可焊性。

■阻燃性外盒和阻燃性树脂。

■金属化聚酯膜，无感结构。

用途

■旁路，隔直，耦合，退耦。

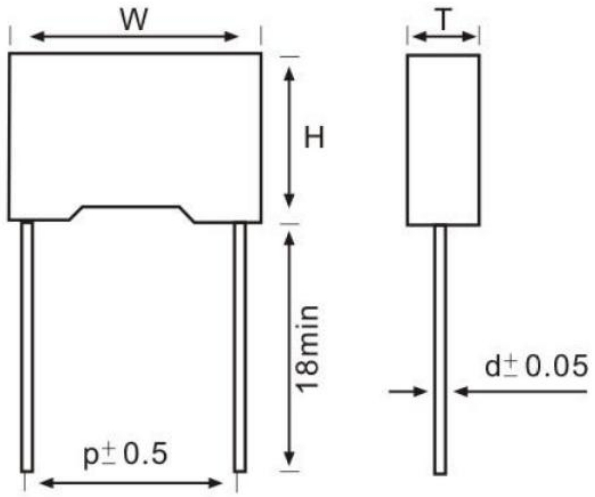
■脉冲，定时，振荡电路。

料号与订货信息请咨询。

技术要求

气候类别	40/100/21
额定电压	100VDC、250VDC、400VDC、630VDC
损耗角正切	≤1.0%(1KHz、1.0Vrms、20℃)
耐电压	$1.6U_R$ (5s)
绝缘电阻	>100V(AT 100VDC 60S) C≤0.33uF,IR≥30000MΩ C＞0.33uF,IR≥10000S ≤100V(AT 10VDC 60S) C≤0.33uF,IR≥15000MΩ C＞0.33uF,IR≥5000S 注：$T[s]=I.R.[M\Omega]*C_N[\mu F]$

外形尺寸 (mm) 和认证

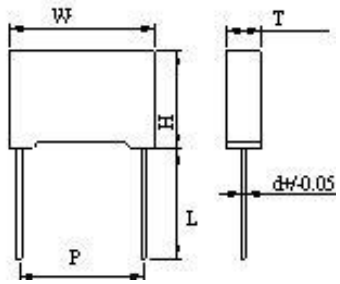
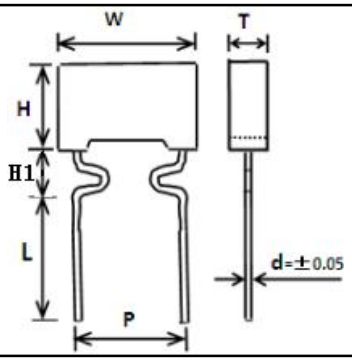


容量(uF)	电压	尺寸 (mm)				
		W±0.5	H±0.5	T±0.5	P±1.0	d±0.05
0.01	100VDC	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6
	250VDC	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6
	400VDC	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6
	630VDC	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6
0.015	100VDC	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6
	250VDC	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6
	400VDC	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6
	630VDC	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6
0.022	100VDC	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6
	250VDC	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6
	400VDC	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6
	630VDC	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6
0.033	100VDC	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6
	250VDC	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6
	400VDC	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6
	630VDC	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6
0.047	100VDC	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6
	250VDC	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6
	400VDC	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6
	630VDC	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6

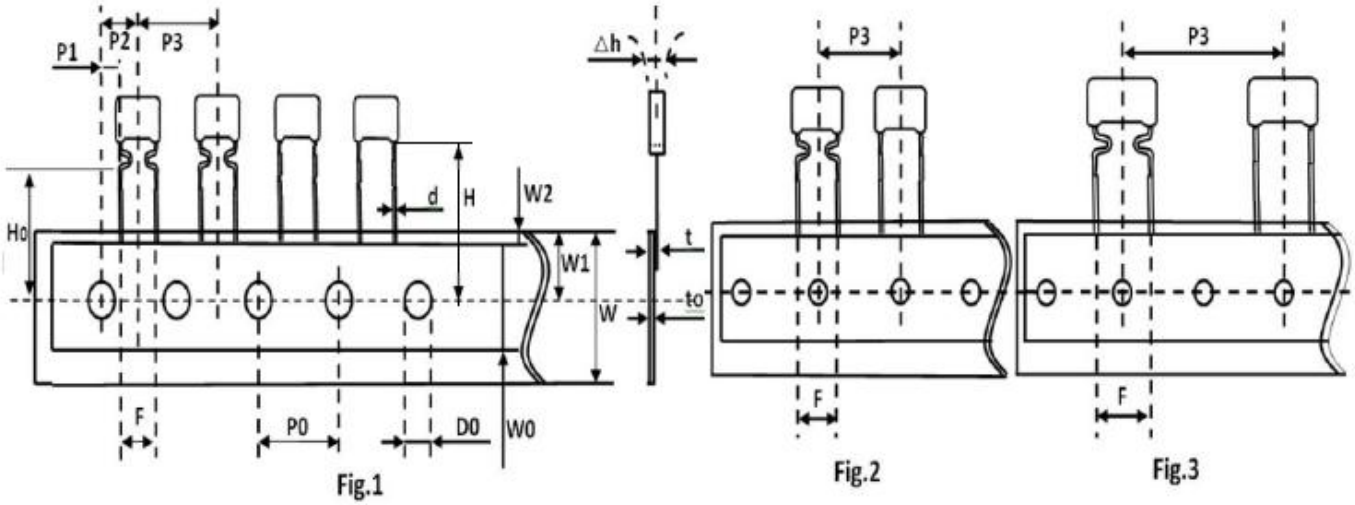
容量(uF)	电压	尺寸 (mm)				
		W±0.5	H±0.5	T±0.5	P±1.0	d±0.05
0.068	100VDC	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6
	250VDC	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6
	400VDC	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6
	630VDC	13.0	12.0	6.0	10.0	0.6
0.1	100VDC	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6
	250VDC	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6
	400VDC	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6
	630VDC	18.0	11.0	6.0	15.0	0.8
0.15	100VDC	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6
	250VDC	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6
	400VDC	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6
	630VDC	18.0	12.0	6.0	15.0	0.8
0.22	100VDC	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6
	250VDC	13.0	12.0	6.0	10.0	0.6
	400VDC	18.0	13.5	7.5	15.0	0.8
	630VDC	18.0	13.5	7.5	15.0	0.8
0.33	100VDC	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6
	250VDC	18.0	12.0	6.0	15.0	0.8
	400VDC	18.0	12.0	6.0	15.0	0.8
	630VDC	18.0	16.0	10.0	15.0	0.8
0.47	100VDC	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6
	250VDC	18.0	12.0	6.0	15.0	0.8
	400VDC	18.0	14.5	8.5	15.0	0.8
	630VDC	26.5	17.0	8.5	22.5	0.8
0.68	100VDC	13.0	12.0	6.0	10.0	0.6
	250VDC	18.0	13.5	7.5	15.0	0.8
	400VDC	18.0	16.0	10.0	15.0	0.8
	630VDC	26.5	19.0	10.0	22.5	0.8
1.0	100VDC	13.0	12.0	6.0	10.0	0.6
	250VDC	18.0	14.5	8.5	15.0	0.8
	400VDC	26.5	17.0	8.5	22.5	0.8
	630VDC	26.5	22.0	12.0	22.5	0.8
1.5	100VDC	18.0	12.0	6.0	15.0	0.8
	250VDC	18.0	19.0	11.0	15.0	0.8
	400VDC	26.5	19.0	10.0	22.5	0.8
	630VDC	32.0	22.0	13.0	27.5	0.8

容量(uF)	电压	尺寸 (mm)				
		W±0.5	H±0.5	T±0.5	P±1.0	d±0.05
2.2	100VDC	26.5	19.0	10.0	22.5	0.8
	250VDC	26.5	19.0	10.0	22.5	0.8
	400VDC	32.0	20.0	11.0	27.5	0.8

脚型、脚长说明

脚型	图示	脚长 L (mm)	高度 H1(mm)
长直脚脚型		①[2.5≤L＜6.0]+/-0.5; ②[6.0≤L≤10]+/-1.0	/
内弯脚型		①[2.5≤L＜6.0]+/-0.5; ②[6.0≤L≤10]+/-1.0	脚距 P＞10mm:H1＜6.0mm 脚距 P≤10mm:H1＜5.0mm

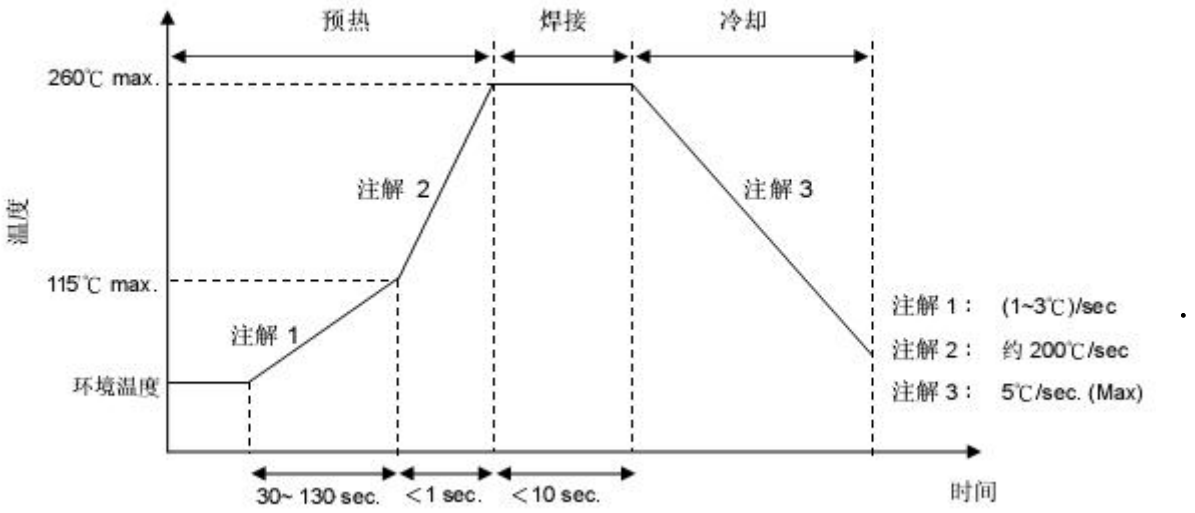
编带尺寸 (mm)

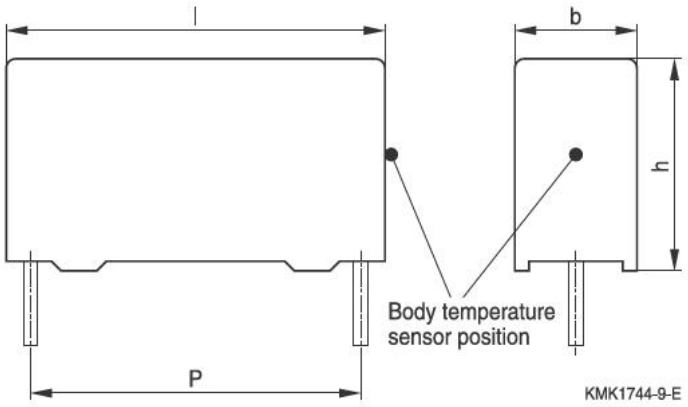


代码	Fig.1	Fig.2	Fig.2	Fig.3	Fig.3	误差
	P=5.0	P=7.5	P=10	P=15	P=20/22.5	
P3	12.7	12.7	12.7	25.4	30.0	±1.0
P2	6.35	/	/	/	/	±1.3
P0	12.7	12.7	12.7	12.7	15.0	±0.3
P1	3.85	/	/	/	/	±0.7
F	5.0	7.5	10.0	15.0	20.0/22.5	±1.0
H	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	±1.0
H0	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	±0.5
Δ h	0	0	0	0	0	±2.0
W	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	+1.0/-0.5
W0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	±1.0
W1	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	±0.5
W2	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	Max
D0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	±0.3
d	0.5	0.6	0.6	0.8	0.8	±0.05
t	1.0	1.1	1.1	1.4	1.4	±0.2
t0	0.38	0.38	0.38	0.47	0.47	±0.04

焊接条件：

波峰焊曲线





PP:
During pre-heating: Tp ≤110℃
During soldering: Ts ≤120℃, ts ≤15 s
PE:
During pre-heating: Tp ≤125℃
During soldering: Ts ≤160℃, ts ≤15 s

烙铁重工焊接条件

项目	条件
烙铁头部温度	350℃(max.)
焊接时间	3 sec(max.)
焊接位置与涂装层距离	2 mm(min.)

注：薄膜电容器不适合回流焊焊接，否则产品会因热收缩导致性能问题。